(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-345041

(P2000-345041A)

(43)公開日 平成12年12月12日(2000.12.12)

(51) Int. Cl. '	識別記号	FI	テーマコード (参考)
C08L 83/04		C08L 83/04	4 J002
C08K 5/06		CO8K 5/06	5F058
H01L 21/312		H01L 21/312	c
21/316		21/316	н

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全12頁)

(21)出願番号	特願平11-158674	(71)出願人 000004178
		ジェイエスアール株式会社
(22)出願日	平成11年6月4日(1999.6.4)	東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者 西川 通則
		東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
		エスアール株式会社内
		(72)発明者 角田 真由美
		東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
		エスアール株式会社内
		(72)発明者 井上 靖健
		東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
		エスアール株式会社内
		· · ·
		最終頁に続

(54) 【発明の名称】膜形成用組成物、膜形成用組成物の製造方法および絶縁膜形成用材料

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、適当な均一な厚さを有する塗膜が形成可能で保存安定性に優れ、塗膜の誘電率やリーク電流特性などに優れた膜形成用組成物。

【解決手段】 (A-1)式(1)で表される化合物

$$R^{1}_{a}Si(OR^{2})_{4\sim a}$$
 ···· (1)

 $(R^1$ は水素原子、フッ素原子または有機基を、 R^2 は有機基を示す。) および (A-2) 式 (2) で表される化合物

$$R_b^3 (R^{4}O)_{3-b}Si - (R^7)_{d} - Si (OR^5)_{3-c}R_c^6$$

 $(R^3, R^4, R^5$ および R^6 は、有機基を、 R^7 は酸素原子または-(CH2)。-、nは $1\sim6$ 、dは0または1を示す。)から選ばれる化合物の加水分解物、縮合物 (B)式(3)で表される溶剤

$$R^{8}O \left(CHCH_{3}CH_{2}O\right)_{e}R^{9} \cdots (3)$$

 $(R^s および R^s は、水素原子、アルキル基または CH、CO-を示し、eは1~2。)を含有し、プロピレングリコールの含有量が <math>10000ppm$ 以下の膜形成用組成物。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (A-1) 下記一般式(1) で表 される化合物

 R^1 S i (OR^2) 4. \cdots (1)

$$R^{3}_{b}$$
 (R⁴O) _{3-b} S i - (R⁷) _d - S i (OR⁵) _{3-c} R⁶.
· · · · · (2)

(R³, R⁴, R⁵およびR⁶は、同一でも異なっていても よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 ーでも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R⁷は 酸素原子またはー(CH2)。一で表される基を示し、n

$$R^{8}O$$
 (CHCH₂CH₂O) . R^{9}

(R°およびR°は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 1~4のアルキル基またはCH, CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。)を含有 し、かつプロピレングリコールの含有量が10000p pm以下であることを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 ナトリウム含有量および鉄含有量がそれ ぞれ15ppb以下であることを特徴とする請求項1記 載の膜形成用組成物。

(C) 触媒が下記一般式(4)で表され 20 される化合物 【請求項3】 る金属のキレート化合物であることを特徴とする請求項 2 記載の膜形成用組成物の製造方法。

$$R^{10}_{f}M(OR^{11})_{ff} \cdots (4)$$

(R"はキレート剤、Mは金属原子、R"は炭素数2~ 5のアルキル基または炭素数6~20のアリール基を示 し、gは金属Mの原子価、fは1~gの整数を表す。)

$$R^{3}_{b}$$
 (R⁴O) _{3-b} S i - (R⁷) _d - S i (OR⁵) _{3-c} R⁶ _c · · · · · (2)

(R³、R⁴、R⁵およびR⁶は、同一でも異なっていても ーでも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R⁷は 酸素原子または- (CH2)。-で表される基を示し、d $R^{*}O$ (CHCH₃ CH₂O), R^{*}

(R®およびR®は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 1~4のアルキル基またはCH₃CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。) および (C) 触媒の存在下で加水分解することを特徴とする請 求項1記載の膜形成用組成物の製造方法。

【請求項7】 請求項1~6記載の膜形成用組成物から なることを特徴とする絶縁膜形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 縁膜材料として、適当な均一な厚さを有する塗膜が形成 可能で保存安定性に優れ、しかも塗膜の誘電率やリーク 電流特性などに優れた膜形成用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁

(R¹は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R²は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表 す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化 合物

は1~6を、dは0または1を示す。) からなる群より 選ばれる少なくとも1種の化合物の加水分解物および縮 合物もしくはいずれか一方ならびに(B)下記一般式 (3)で表される溶剤

$\cdots \cdots (3)$

【請求項4】 (C) 触媒が酸触媒であることを特徴と する請求項2記載の膜形成用組成物の製造方法。

【請求項5】 さらにβージケトン、ポリアルキレンオ キシド構造を有する化合物および(メタ)アクリル系重 合体よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物を 含有することを特徴とずる請求項1または2記載の膜形 成用組成物。

(A) (A-1) 下記一般式(1) で表 【請求項6】

$$R^1$$
 S i (OR^2) \cdots (1)

(R¹は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R²は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表 す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化 合物

は0または1を示す。) からなる群より選ばれる少なく よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 30 とも1種の化合物を(B)下記一般式(3)で表され、 ガスクロマトグラフィーで測定した場合の純度が99% 以上である溶剤

 $\cdots (3)$

たシリカ (SiO2) 膜が多用されている。そして、 近年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的とし て、SOG (Spin onGlass) 膜と呼ばれる テトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする **塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、** 半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれ 40 るポリオルガノシロキサンを主成分とする低誘電率の層 間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導体素子 などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導 体間の電気絶縁性が要求されており、したがって、保存 安定性が良好でより低誘電率でリーク電流特性に優れる 層間絶縁膜材料が求められるようになっている。

【0003】そこで、特開平6-181201号公報に は、層間絶縁膜材料として、より低誘電率の絶縁膜形成 用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物 は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の 膜として、CVD法などの真空プロセスで以て形成され 50 絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、

チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ば れる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分 子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素 化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以 上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成 物である。

【0004】また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶縁膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素プ ラズマ性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成用材料が開 示されている。

【0005】さらに、特開平3-20377号公報に は、電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な 酸化物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物 被膜形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布 液を提供し、また、この塗布液を用いることにより、高 温での硬化、酸素プラズマによる処理を行った場合であ っても、クラックのない良好な酸化物被膜を得ることを 目的としている。そして、その構成は、所定のシラン化 20 合物 合物と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の存

$$R^{3}$$
, $(R^{4}O)_{3+}$ Si $- (R^{7})_{4}$ - Si $(OR^{5})_{3+}$ R^{6} .

(R³、R⁴、R⁵およびR⁶は、同一でも異なっていても よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 ーでも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R'は 酸素原子または- (CH2)。-で表される基を示し、n は1~6を、dは0または1を示す。) から選ばれる少 $R^{8}O$ (CHCH₃ CH₂O), R^{9}

(R®およびR®は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 30 オロフェニル基などを挙げることができる。 1~4のアルキル基またはCH₃CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。)を含有 することを特徴とする膜形成用組成物、その製造方法お よび絶縁膜形成用材料を提供するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】

【0010】(A)成分

(A-1)成分

上記一般式(1)において、R'およびR'の1価の有機 基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリ シジル基などを挙げることができる。また、一般式 (1) において、R¹は1価の有機基、特にアルキル基 またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アル キル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブ チル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であ り、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよ く、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていて もよい。一般式(1)において、アリール基としては、 フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフ 在化で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成用 塗布液である。

【0006】しかし、上記のようにシラン化合物にチタ ンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合せ た場合、途膜の均一性や保存安定性が優れず、さらに誘 電率、リーク電流などをバランスよく有するものではな V10

[0007]

(1)で表される化合物

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 10 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、塗膜均 一性や保存安定性に優れ、誘電率やリーク電流特性にも 優れた層間絶縁膜用材料を提供することを目的とする。 【0008】本発明は、(A) (A-1) 下記一般式

 R^1 a S i (OR^2) 4 – a

(R'は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、 R^{2} は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表 す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化

なくとも1種の化合物の加水分解物および縮合物もしく はいずれか一方ならびに(B)下記一般式(3)で表さ れ、ガスクロマトグラフィーで測定した場合の純度が9 9%である溶剤

 $\cdots (3)$

【0011】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、ト リーn-プロポキシシラン、トリーiso-プロポキシ シラン、トリーnーブトキシシラン、トリーsecーブ トキシシラン、トリーtertーブトキシシラン、トリ フェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フル オロトリエトキシシラン、フルオロトリーn-プロポキ シシラン、フルオロトリーisoープロポキシシラン、 フルオロトリーn-ブトキシシラン、フルオロトリーs 40 ec-ブトキシシラン、フルオロトリーtert-ブト キシシラン、フルオロトリフェノキシシラン、テトラメ トキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーnープ ロポキシシラン、テトラーisoープロポキシシラン、 テトラーnーブトキシラン、テトラーsecーブトキシ シラン、テトラーtertーブトキシシラン、テトラフ ェノキシシランなど:メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、メチルトリーnープロポキシシ ラン、メチルトリーiso-プロポキシシラン、メチル トリーn-ブトキシシラン、メチルトリーsec-ブト ェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フル 50 キシシラン、メチルトリーtert-ブトキシシラン、

メチルトリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラ ン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリーn-プロ ポキシシラン、エチルトリーiso-プロポキシシラ ン、エチルトリーnープトキシシラン、エチルトリーs ec-ブトキシシラン、エチルトリーtert-ブトキ シシラン、エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメ トキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリ -n-プロポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポ キシシラン、ビニルトリーn-ブトキシシラン、ビニル トリーsecーブトキシシラン、ビニルトリーtert ープトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキ シシラン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、 n-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、n-プ ロピルトリーnーブトキシシラン、nープロピルトリー secーブトキシシラン、nープロピルトリーtert ープトキシシラン、n-プロピルトリフェノキシシラ ン、iープロピルトリメトキシシラン、iープロピルト リエトキシシラン、i-プロピルトリーn-プロポキシ シラン、iープロピルトリーisoープロポキシシラ ン、iープロピルトリーnーブトキシシラン、iープロ ピルトリーsecーブトキシシラン、iープロピルトリ -tert-ブトキシシラン、i-プロピルトリフェノ キシシラン、nーブチルトリメトキシシラン、nーブチ ルトリエトキシシラン、n-ブチルトリーn-プロポキ シシラン、nープチルトリーisoープロポキシシラ ン、nープチルトリーnープトキシシラン、nープチル トリーsec-ブトキシシラン、n-ブチルトリーte rtーブトキシシラン、nーブチルトリフェノキシシラ ン、secーブチルトリメトキシシラン、secーブチ ルーiートリエトキシシラン、secーブチルートリー n-プロポキシシラン、sec-ブチルートリーiso ープロポキシシラン、secーブチルートリーnーブト キシシラン、secーブチルートリーsecーブトキシ シラン、secーブチルートリーtertーブトキシシ ラン、secーブチルートリフェノキシシラン、tーブ チルトリメトキシシラン、tーブチルトリエトキシシラ ン、tーブチルトリーnープロポキシシラン、tーブチ ルトリーisoープロポキシシラン、tーブチルトリー n-ブトキシシラン、t-ブチルトリーsec-ブトキ 40 ec-ブチルージーsec-ブトキシシラン、ジーse シシラン、tープチルトリーtertーブトキシシラ ン、tープチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメ トキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニル トリーnープロポキシシラン、フェニルトリーisoー プロポキシシラン、フェニルトリーnーブトキシシラ ン、フェニルトリーsecーブトキシシラン、フェニル トリーtertーブトキシシラン、フェニルトリフェノ キシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエ トキシシラン、γーアミノプロピルトリメトキシシラ ン、ヮーアミノプロピルトリエトキシシラン、ヮーグリ

6 シドキシプロピルトリメトキシシラン、ャーグリシドキ シプロピルトリエトキシシラン、γートリフロロプロピ ルトリメトキシシラン、γートリフロロプロピルトリエ トキシシランなど:ジメチルジメトキシシラン、ジメチ ルジエトキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシ ラン、ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメ チルージーnープトキシシラン、ジメチルージーsec ープトキシシラン、ジメチルージーtertープトキシ シラン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメト 10 キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージ -n-プロポキシシラン、ジエチルージーiso-プロ ポキシシラン、ジエチルージ-n-ブトキシシラン、ジ エチルージー s e c ープトキシシラン、ジエチルージー tertープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラ ン、ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロ ピルジエトキシシラン、ジーn-プロピルージーn-プ ロポキシシラン、ジーnープロピルージーisoープロ ポキシシラン、ジーn-プロピルージーn-ブトキシシ ラン、ジーnープロピルージーsecーブトキシシラ 20 ン、ジーnープロピルージーtertーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーフェノキシシラン、ジーi so-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プロピ ルジエトキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-プロポキシシラン、ジーisoープロピルージーiso ープロポキシシラン、ジーisoープロピルージーnー ブトキシシラン、ジーiso-プロピルージーsec-ブトキシシラン、ジーiso-プロピルージーtert ープトキシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノ キシシラン、ジーn-ブチルジメトキシシラン、ジーn 30 ープチルジエトキシシラン、ジーnープチルージーnー プロポキシシラン、ジーnーブチルージーisoープロ ポキシシラン、ジーn-ブチルージ-n-ブトキシシラ ン、ジーnープチルージーsecーブトキシシラン、ジ -n-ブチルージーtert-ブトキシシラン、ジーn ープチルージーフェノキシシラン、ジーsecープチル ジメトキシシラン、ジーsec-ブチルジエトキシシラ ン、ジーsecーブチルージーnープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーisoープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーs cーブチルージーtertーブトキシシラン、ジーse c-ブチルージーフェノキシシラン、ジーtert-ブ チルジメトキシシラン、ジーtertーブチルジエトキ シシラン、ジーtert-ブチルージーn-プロポキシ シラン、ジーtertーブチルージーisoープロポキ シシラン、ジーtertーブチルージーnーブトキシシ ラン、ジーtertープチルージーsecーブトキシシ ラン、ジーtertープチルージーtertープトキシ シラン、ジーtert-ブチルージーフェノキシシラ 50 ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエ

トキシシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラ ン、ジフェニルージーisoープロポキシシラン、ジフ ェニルージーnーブトキシシラン、ジフェニルージーs ecーブトキシシラン、ジフェニルージーtertーブ トキシシラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニ ルトリメトキシシラン、yーアミノプロピルトリメトキ シシラン、γーアミノプロピルトリエトキシシラン、γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、y-グリ シドキシプロピルトリエトキシシラン、γートリフロロ プロピルトリメトキシシラン、ソートリフロロプロピル トリエトキシシランなど;を挙げることができる。好ま しくは、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン、テトラーnープロポキシシラン、テトラーisoー プロポキシシラン、テトラフェノキシシラン、メチルト リメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチル トリーnープロポキシシラン、メチルトリーisoープ ロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルト リエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニル トリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラ ン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシ ラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキ シシラン、ジフェニルジエトキシシラン、トリメチルモ ノメトキシシラン、トリメチルモノエトキシシラン、ト リエチルモノメトキシシラン、トリエチルモノエトキシ シラン、トリフェニルモノメトキシシラン、トリフェニ ルモノエトキシシランである。これらは、1種あるいは 2種以上を同時に使用してもよい。

【0012】(A-2)成分

の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。 また、一般式(2)のR'である2価の有機基として は、メチレン基、炭素数2~6のアルキレン基などを挙 げることができる。一般式(2)のうち、R'が酸素原 子の化合物としては、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘ キサエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキシジシロキ サン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシー3-メチ ルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ -3-メチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペン タメトキシー3-フェニルジシロキサン、1,1,1, 3, 3-ペンタエトキシー3-フェニルジシロキサン、 1, 1, 3, 3ーテトラメトキシー1, 3ージメチルジ シロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3 ージメチルジシロキサン、1,1,3,3ーテトラメト キシー1, 3ージフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1、3-ジフェニルジシロキサ ン、1, 1, 3-トリメトキシー1, 3, 3-トリメチ ルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシー1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1,1,3-トリメトキ シー1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 1,

3-トリエトキシー1, 3, 3-トリフェニルジシロキ サン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメ チルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3 ージエトキシー1、1、3、3ーテトラフェニルジシロ キサンなどを挙げることができる。これらのうち、ヘキ サメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサ 10 ルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー 1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト ラメトキシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 3 ージメトキシー1、1、3、3ーテトラメチルジシロキ サン、1、3-ジエトキシ-1、1、3、3-テトラメ チルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1,3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシ -1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなど を、好ましい例として挙げることができる。一般式 (2) において dが 0 の化合物としては、ヘキサメトキ 20 シジシラン、ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェニキ シジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシー2 ーメチルジシラン、1,1,1,2,2ーペンタエトキ シー2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタ メトキシー2-フェニルジシラン、1,1,1,2,2 $-\mathcal{C}$ 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、 1, 1, 2, 2ーテトラエトキシー1, 2ージメチルジ シラン、1, 1, 2, 2ーテトラメトキシー1, 2ージ フェニルジシラン、1,1,2,2-テトラエトキシー 上記一般式(2)において、1価の有機基としては、先 30 1,2-ジフェニルジシラン、1,1,2-トリメトキ シー1, 2, 2ートリメチルジシラン、1, 1, 2ート リエトキシー1, 2, 2ートリメチルジシラン、1, 1, 2ートリメトキシー1, 2, 2ートリフェニルジシ ラン、1, 1, 2-トリエトキシー1, 2, 2-トリフ ェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2 ーテトラメチルジシラン、1,2ージエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキ シ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2 -ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラ 40 ンなどを、一般式 (2) においてR'が- (CH2) n-で表される基の化合物としては、ビス (ヘキサメトキシ シリル) メタン、ビス (ヘキサエトキシシリル) メタ ン、ビス(ヘキサフェノキシシリル)メタン、ビス(ジ メトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジエトキシメチ ルシリル) メタン、ビス (ジメトキシフェニルシリル) メタン、ビス(ジエトキシフェニルシリル)メタン、ビ ス(メトキシジメチルシリル)メタン、ビス(エトキシ ジメチルシリル) メタン、ビス (メトキシジフェニルシ リル) メタン、ビス (エトキシジフェニルシリル) メタ

50 ン、ビス(ヘキサメトキシシリル)エタン、ビス(ヘキ

サエトキシシリル) エタン、ビス (ヘキサフェノキシシ リル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) エタ ン、ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、ビス (ジ メトキシフェニルシリル)エタン、ビス(ジエトキシフ エニルシリル) エタン、ビス (メトキシジメチルシリ ル) エタン、ビス (エトキシジメチルシリル) エタン、 ビス (メトキシジフェニルシリル) エタン、ビス (エト キシジフェニルシリル) エタン、1,3-ビス(ヘキサ メトキシシリル)プロパン、1,3-ビス(ヘキサエト キシシリル) プロパン、1,3-ビス(ヘキサフェノキ シシリル)プロパン、1,3-ビス(ジメトキシメチル シリル)プロパン、1、3-ビス(ジエトキシメチルシ リル)プロパン、1、3-ビス(ジメトキシフェニルシ リル) プロパン、1、3-ビス (ジエトキシフェニルシ リル)プロパン、1、3-ビス(メトキシジメチルシリ ル) プロパン、1, 3-ビス (エトキシジメチルシリ ル) プロパン、1, 3-ビス (メトキシジフェニルシリ ル) プロパン、1, 3-ビス (エトキシジフェニルシリ ル) プロパンなどを挙げることができる。これらのう ち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラ ン、ヘキサフェニキシジシラン、1,1,2,2ーテト ラメトキシー1、2-ジメチルジシラン、1、1、2、 2-テトラエトキシー1,2-ジメチルジシラン、1, $R^{8}O$ (CHCH₃ CH₂O) , R^{9}

(R®およびR®は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 1~4のアルキル基またはCH₃CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。)であ る。ここで、溶剤1のガスクロマトグラフィーにより測 定した純度は99%以上、好ましくは99.5%以上で ある。溶剤1としては、ロピレングリコールモノメチル エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、 プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレ ングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコー ルジメチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエ ーテル、プロピレングリコールジプロピルエーテル、プ ロピレングリコールジブチルエーテル、ジプロピレング リコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコール モノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロ ピルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエー テル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、ジプ ロピレングリコールジエチルエーテル、ジプロピレング リコールジプロピルエーテル、ジプロピレングリコール ジブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノプロピル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノブチル エーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチ ルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノエ チルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノ プロピルエーテルアセテート、ジプロピレングリコール 50 1,200~100,000程度である。

1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジフェニルジシ ラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジフ ェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2 -テトラメチルジシラン、1,2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキ シー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラン、1, 2 ージエトキシー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラ ン、ビス(ヘキサメトキシシリル)メタン、ビス(ヘキ サエトキシシリル) メタン、ビス (ジメトキシメチルシ 10 リル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタ ン、ビス (ジメトキシフェニルシリル) メタン、ビス (ジエトキシフェニルシリル) メタン、ビス (メトキシ ジメチルシリル) メタン、ビス (エトキシジメチルシリ ル) メタン、ビス (メトキシジフェニルシリル) メタ ン、ビス (エトキシジフェニルシリル) メタンを、好ま しい例として挙げることができる。本発明において、 (A) 成分としては、上記 (A-1) 成分および (A-2) 成分、もしくはいずれか一方を用い、(A-1) 成 分および (A-2) 成分はそれぞれ2種以上用いること 20 もできる。

【0013】(B)成分

本発明の(B)成分は下記一般式(3)で表される溶剤 (以下「溶剤1」という)

 $\cdots (3)$

モノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコール ジアセテート、ジプロピレングリコールジアセテートな どが挙げられ、特にプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プ ロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレン 30 グリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコール ジメチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエー テル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ ート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテ ート、プロピレングリコールモノプロピルエーテルアセ テートが好ましい。これらは1種または2種以上を同時 に使用することができる。

【0014】本発明において、加水分解とは、上記 (A) 成分に含まれるR'O-基、R'O-基、およびR ⁶〇-基すべてが加水分解されている必要はなく、例え 40 ば1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水 分解されているもの、あるいは、これらの混合物が生成 することである。本発明において縮合とは(A)成分の 加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結 合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基 がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノ ール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているもの の混合物などをも生成することを包含した概念である。 なお、(A)成分の加水分解縮合物の重量平均分子量 は、通常、1,000~120,000、好ましくは

【0015】本発明において(B)成分の使用量は(A)成分(完全加水分解縮合物換算)0.3~25倍量(重量)の範囲である。なお、本発明において完全加水分解縮合物とは (A)成分に含まれるR²O-基

11

量(重量)の範囲である。なお、本発明において完全加水分解縮合物とは、(A)成分に含まれるR²O-基、R⁴O-基、およびR⁵O-基が100%加水分解してOH基となり、完全に統合したものを示す

H基となり、完全に縮合したものを示す。 【0016】本発明の膜形成用組成物は、さらに下記の 有機溶剤を溶剤1の50重量%以下含有していてもよ い。本発明に使用する有機溶剤としては、例えば、n-ペンタン、iーペンタン、nーヘキサン、iーヘキサ ン、n-ヘプタン、i-ヘプタン、2, 2, 4-トリメ チルペンタン、nーオクタン、iーオクタン、シクロへ キサン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素系 溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼ ン、トリメチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、n-プロピルベンセン、iープロピルベンセン、ジエチルベ ンゼン、iーブチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ジ -i-プロピルベンセン、n-アミルナフタレン、トリ メチルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒;;アセト ン、メチルエチルケトン、メチルーnープロピルケト ン、メチルーnープチルケトン、ジエチルケトン、メチ ルーiープチルケトン、メチルーnーペンチルケトン、 エチルーnープチルケトン、メチルーnーヘキシルケト ン、ジーiープチルケトン、トリメチルノナノン、シク ロヘキサノン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノ ン、2,4-ペンタンジオン、アセトニルアセトン、ジ アセトンアルコール、アセトフェノン、フェンチョンな どのケトン系溶媒;エチルエーテル、i-プロピルエー テル、n-ブチルエーテル、n-ヘキシルエーテル、2 -エチルヘキシルエーテル、エチレンオキシド、1,2 ープロピレンオキシド、ジオキソラン、4ーメチルジオ キソラン、ジオキサン、ジメチルジオキサン、エチレン グリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモ ノエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテ ル、エチレングリコールモノーn-ブチルエーテル、エ チレングリコールモノーnーヘキシルエーテル、エチレ ングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコー ルモノ-2-エチルブチルエーテル、エチレングリコー ルジブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチル エーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、 ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレング

リコールモノーnープチルエーテル、ジエチレングリコ

ールジ-n-ブチルエーテル、ジエチレングリコールモ

ノーn-ヘキシルエーテル、エトキシトリグリコール、

テトラエチレングリコールジ-n-ブチルエーテル、ト

リプロピレングリコールモノメチルエーテル、テトラヒ

ドロフラン、2-メチルテトラヒドロフランなどのエー

テル系溶媒:ジエチルカーボネート、酢酸メチル、酢酸

エチル、γーブチロラクトン、γーバレロラクトン、酢

酸nープロピル、酢酸iープロピル、酢酸nーブチル、

酢酸 i ープチル、酢酸 s e c ープチル、酢酸 n ーペンチ ル、酢酸secーペンチル、酢酸3-メトキシブチル、 酢酸メチルペンチル、酢酸2-エチルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシル、 酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸n-ノニル、アセト酢 酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレングリコール モノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノエチ ルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメチルエー テル、酢酸ジエチレングリコールモノエチルエーテル、 10 酢酸ジエチレングリコールモノーn-ブチルエーテル、 酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プ ロピオン酸 n - ブチル、プロピオン酸 i - アミル、シュ ウ酸ジエチル、シュウ酸ジーnーブチル、乳酸メチル、 乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミル、マロン 酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなど のエステル系溶媒; N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルムアミ ド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルプロピオンアミド、 20 Nーメチルピロリドンなどの含窒素系溶媒:硫化ジメチ ル、硫化ジエチル、チオフェン、テトラヒドロチオフェ ン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、1、3ープロ パンスルトンなどの含硫黄系溶媒などを挙げることがで きる。これらは、1種あるいは2種以上を混合して使用 することができる。

【0017】本発明の膜形成用組成物は、さらに下記のような成分を含有してもよい。

βージケトン

 β -ジケトンとしては、アセチルアセトン、2,4- α 30 キサンジオン、2,4- α 7タンジオン、3,5- α 7タンジオン、2,4- α 7タンジオン、3,5- α 7タンジオン、2,4- α 7月カンジオン、3,5- α 7月カンジオン、2,4- α 7月カンジオン、2,2,6,6- α 7月カンジオルー3,5- α 7月カンジオン、1,1,5,5,5- α 7月カンジオンなどの1種または2種以上である。本発明において、膜形成用組成物中の α 9- α 7月ングトン含有量は、

(A) 成分(完全加水分解縮合物換算)の合計量100 重量部に対して通常0.1~100重量部、好ましくは 40 0.2~80重量部の範囲である。このような範囲でβ ージケトンを添加すれば、一定の保存安定性が得られる とともに、膜形成用組成物の塗膜均一性などの特性が低 下するおそれが少ない。このβージケトンは、(A) 成 分の加水分解、縮合反応後に添加することが好ましい。

【0018】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活 性剤などの成分を添加してもよい。コロイド状シリカと は、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒 50 に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~30m μ 、好ましくは $10\sim20$ m μ 、固形分濃度が $10\sim4$ 0重量%程度のものである。このような、コロイド状シ リカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、メタノ ールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル;触 媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。コロ イド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアル ミナゾル520、同100、同200;川研ファインケ ミカル (株) 製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル 10、同132などが挙げられる。有機ポリマーとして は、例えば、ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 10 ン、トリーt-ブトキシ・モノ(アセチルアセトナー 合物、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合 体、(メタ) アクリル系重合体、芳香族ビニル化合物、 デンドリマー、ポリイミド, ポリアミック酸、ポリアリ ーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサジ アゾール、フッ素系重合体などを挙げることができる。 界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性剤、 アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界 面活性剤などが挙げられ、さらには、シリコーン系界面 活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、ポリ (メタ) アクリレート系界面活性剤などを挙げることが できる。

【0019】本発明の膜形成用組成物の全固形分濃度 は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応 じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30 重量%であると、途膜の膜厚が適当な範囲となり、保存 安定性もより優れるものである。本発明の膜形成用組成 物はプロピレングリコール含有量が10000ppm以 下、好ましくは5000ppm以下である。プロピレン グリコール含有量が10000ppmを超えると、塗膜 の保存安定性が悪化するという問題が生じやすい。さら に、本発明の組成物のナトリウム含有量および鉄含有量 がそれぞれ15ppb以下である。ナトリウム含有量お よび鉄含有量のいずれか一方でも15ppbを超える と、塗膜のリーク電流が上昇するという問題が生じやす い。

【0020】本発明の組成物は、(A)成分を溶剤1に 溶解した、通常触媒および水を添加して(A)成分の加 水分解を行うにより製造する。上記(A)成分を加水分 解、縮合させる際に、(A-1)成分および(A-2) 成分が有するR²O-、R¹O-およびR⁵O-で表され る基1モル当たり、0.25~3モルの水を用いること が好ましく、0.3~2.5モルの水を加えることが特 に好ましい。添加する水の量が0.25~3モルの範囲 内の値であれば、塗膜の均一性が低下する恐れが無く、 また、膜形成用組成物の保存安定性が低下する恐れが少 ないためである。さらに、水は断続的あるいは連続的に 添加されることが好ましい。本発明において、(A)成 分を加水分解するときの温度は通常0~100℃、好ま しくは15~80℃である。

【0021】(A)成分を加水分解、縮合させる際に

は、触媒を使用してもよい。この際に使用する触媒とし ては、金属キレート化合物、有機酸、無機酸、有機塩 基、無機塩基を挙げることができる。金属キレート化合 物としては、例えば、トリエトキシ・モノ(アセチルア セトナート) チタン、トリーn-プロポキシ・モノ(ア セチルアセトナート) チタン、トリーi-プロポキシ・ モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーnーブト キシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーs e c - ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタ ト) チタン、ジエトキシ・ビス (アセチルアセトナー ト) チタン、ジーn-プロポキシ・ビス (アセチルアセ トナート) チタン、ジーi-プロポキシ・ビス (アセチ ルアセトナート) チタン、ジ-n-プトキシ・ビス (ア セチルアセトナート) チタン、ジーsec - ブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジー t ープトキ シ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、モノエトキ シ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーn -プロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタ ン、モノーi-プロポキシ・トリス(アセチルアセトナ ート) チタン、モノーn-ブトキシ・トリス(アセチル アセトナート) チタン、モノーsecーブトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) チタン、モノー t ープトキ シ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、テトラキ ス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーnープロ ポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリ -i-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チ タン、トリーnーブトキシ・モノ (エチルアセトアセテ 30 ート) チタン、トリーsecープトキシ・モノ (エチル アセトアセテート) チタン、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーnープロポキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーiー プロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 ジーn-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チ タン、ジーsecーブトキシ・ビス (エチルアセトアセ テート) チタン、ジーtープトキシ・ビス (エチルアセ トアセテート) チタン、モノエトキシ・トリス (エチル 40 アセトアセテート) チタン、モノーn-プロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) チタン、モノー i ープ ロポキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノーn-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテー ト) チタン、モノーsecーブトキシ・トリス (エチル アセトアセテート) チタン、モノー t ープトキシ・トリ ス (エチルアセトアセテート) チタン、テトラキス (エ チルアセトアセテート) チタン、モノ (アセチルアセト ナート) トリス (エチルアセトアセテート) チタン、ビ ス (アセチルアセトナート) ビス (エチルアセトアセテ 50 ート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ

30

40

(エチルアセトアセテート) チタンなどのチタンキレー ト化合物: トリエトキシ・モノ (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリーn-プロポキシ・モノ (アセ チルアセトナート) ジルコニウム、トリーi-プロポキ シ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ -n-プトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーsecーブトキシ・モノ (アセチルアセ トナート) ジルコニウム、トリー t ープトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジーi-プロポキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジ-n-ブトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーt-ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジ ルコニウム、モノーn-プロポキシ・トリス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノー i ープロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、モノーsecーブトキシ・トリス(アセチルア セトナート) ジルコニウム、モノー t ーブトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリエトキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリ -n-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ ルコニウム、トリー i ープロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、トリーnープトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリー s e c ープトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、ジーnープロポキシ・ ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーi ープロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、ジーn-プトキシ・ビス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーtーブトキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モ ノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、モノーnープロポキシ・トリス(エチルアセト アセテート) ジルコニウム、モノーiープロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノーsecーブトキシ・トリス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノー t ープトキシ・ トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、テト ラキス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテ

ート)ジルコニウム、ビス(アセチルアセトナート)ビ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト)ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物; トリス (アセチルアセトナート) アルミニウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウムなどのアルミ ニウムキレート化合物;などを挙げることができる。 【0022】有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオ ン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン ビス(アセチルアセトナート)ジルコニウム、ジーn- 10 酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレ イン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没 食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、 2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リ ノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、 p ー アミノ安息香酸、pートルエンスルホン酸、ベンゼンス ルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン 酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げ ることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝 酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。 【0023】有機塩基としては、例えば、ピリジン、ピ ロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノ ールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ロ人ナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルア ンモニウムハイドロオキサイドなどを挙げることができ る。無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナ

> 【0024】これら触媒のうち、金属キレート化合物、 有機酸、無機酸が好ましく、より好ましくは、チタンキ レート化合物、有機酸を挙げることができる。これらは 1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

> トリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化カ

ルシウムなどを挙げることができる。

【0025】上記触媒の使用量は、(A)成分(完全加 水分解縮合物換算)の合計量100重量部に対して、通 常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~1 0 重量部の範囲である。また、触媒は、前記溶剤中に予 め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解ある いは分散させておいてもよい。

【0026】本発明において、膜形成用組成物中の沸点 100℃以下のアルコールの含量が、20重量%以下、 特に5重量%以下であることが好ましい。沸点100℃ 以下のアルコールは、上記(A-1)成分ならびに(A -2)成分の加水分解および/またはその縮合の際に生 じる場合があり、その含量が20重量%以下、好ましく は5重量%以下になるように蒸留などにより除去するこ とが好ましい。

50 【0027】本発明の組成物を、シリコンウエハ、Si O2 ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際に は、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー 法などの塗装手段が用いられる。

17

【0028】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗 りで厚さ0. 05~1. 5 μ m程度、2回塗りでは厚さ $0.1 \sim 3 \mu m程度の塗膜を形成することができる。そ$ の後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度 の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥するこ とにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成す ることができる。この際の加熱方法としては、ホットプ 10 レート、オーブン、ファーネスなどを使用することが出 来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴ ン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下 などで行うことができる。

【0029】このようにして得られる層間絶縁膜は、絶 縁性に優れ、塗布膜の均一性、誘電率特性、強膜の耐ク ラック性、塗膜の表面硬度に優れることから、LSI、 システムレシ、DRAM、SDRAM、RDRAM、D -RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜、半導体素 子の表面コート膜などの保護膜、多層配線基板の層間絶 縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁防止膜などの用途 に有用である。

[0030]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体 的に説明する。なお、実施例および比較例中の部および %は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%で あることを示している。また、実施例中における膜形成 用組成物の評価は、次のようにして測定したものであ る。

【0031】重量平均分子量(Mw)

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ 一(GPC)法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分 解縮合物1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶 解して調製した。

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標 準ポリスチレンを使用した。

装置:米国ウオーターズ社製の髙温高速ゲル浸透クロマ トグラム (モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M 40 (長さ50cm)

測定温度:40℃

流速:1cc/分

【0032】膜厚均一性

形成用組成物を、8インチシリコンウエハ上に、スピン コーターを用いて、回転数1,700rpm、30秒の 条件で以て塗布した。その後、95℃の温度に保持した ホットプレートを用いて、膜形成用組成物を塗布したシ リコンウエハを5分間加熱し、有機溶媒を飛散させた。 次いで、210℃の温度に保持したホットプレートを用 50 ○;リーク電流が7×10° A未満

いて、膜形成用組成物を塗布したシリコンウエハを5分 間加熱し、シリコンウエハ上に塗膜を形成させた。この ようにして得られた金膜の膜厚を、光学式膜厚計(Ru dolph Technologies社製、Spec tra Laser200) を用いて塗膜面内で50点 測定した。得られた膜厚の3σを計算し、下記基準で評 価した。

○; 塗膜の3 σ が 3 5 n m 未満

×; 塗膜の3σが35nm以上

【0033】保存安定性

37℃で35日保存した膜形成用組成物を、8インチシ リコンウエハ上に、スピンコーターを用いて、回転数 1, 700 r p m、30秒の条件で以て塗布した。その 後、95℃の温度に保持したホットプレートを用いて、 膜形成用組成物を塗布したシリコンウエハを5分間加熱 し、有機溶媒を飛散させた。次いで、210℃の温度に 保持したホットプレートを用いて、膜形成用組成物を塗 布したシリコンウエハを5分間加熱し、シリコンウエハ 上に塗膜を形成させた。このようにして得られた塗膜の 膜厚を、光学式膜厚計 (Rudolph Techno 20 logies社製、Spectra Laser20 0)を用いて塗膜面内で50点測定した。得られた膜厚 の膜厚を測定し、下式により求めた膜厚増加率により、 保存安定性を評価した。

膜厚増加率(%)=((保存後の膜厚)-(保存前の膜 厚))÷(保存前の膜厚)×100

○: 膜厚変化率 ≦10%

△:10%< 膜厚変化率 ≦20%

×:20%< 膜厚変化率

【0034】誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で95℃で5分 間、210℃で5分間基板を乾燥し、さらに450℃の 真空雰囲気のオーブン中で70分基板を焼成した。得ら れた基板上にアルミニウムを蒸着し、誘電率評価用基板 を作製した。誘電率は、横川・ヒューレットパッカード (株) 製のHP16451B電極およびHP4284A プレシジョンLCRメーター用いて、10kHzにおけ る容量値から算出した。

【0035】リーク電流

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で95℃で5分 間、210℃で5分間基板を乾燥し、さらに450℃の 真空雰囲気のオーブン中で70分基板を焼成した。得ら れた基板上にアルミニウムを蒸着し、リーク電流評価用 基板を作製した。リーク電流は、Keithley

(株) 製の6517Aを使用し、塗膜に0.2MV/c mの電圧を印可した際の電流値を測定した。下記基準で **塗膜のリーク電流を評価した。**

×:リーク電流が7×10[™] A以上

【0036】合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン135. 7gとビス (トリエトキシシリル) メタン 48.2 g と ジイソプロポキシチタンビスエチルアセチ ルアセテート1.1gを、石英容器用いて2回蒸留精製 したプロピレングリコールモノプロピルエーテル135 gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、 溶液温度を60℃に安定させた。次に、イオン交換水7 5gを1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で 2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。こ の反応液に、石英容器用いて2回蒸留精製したプロピレ ングリコールモノプロピルエーテル190gを添加し、 50℃で反応液からメタノールおよびエタノールを含む 溶液を190gエバポレーションで除去し、反応液 Oを 得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子 量は、5、700であった

【0037】合成例2

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン101. 8gと1, 1, 3, 3-テトラエトキシー 1,3-ジメチルシロキサン70.4gを、石英容器用 いて2回蒸留精製したプロピレングリコールモノメチル エーテル159gに溶解させたのち、スリーワンモータ ーで攪拌させ、溶液温度を60℃に安定させた。次に、 マレイン酸4.4gを溶解させたイオン交換水70gを 1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間 反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この反応 液に、石英容器用いて2回蒸留精製したプロピレングリ コールモノメチルエーテル210gを添加し、50℃で 反応液からメタノールおよびエタノールを含む溶液を2 10gエバポレーションで除去し、反応液②を得た。こ のようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、 4,000であった。

【0038】比較合成例1

合成例1において、蒸留精製を行っていないプロピレン グリコールモノプロピルエーテルを使用した以外は合成 例1と同様に反応を行い、重量平均分子量5,500の 反応液③を得た。

【0039】実施例1

合成例 1 で得られた反応液 Φを 0.2 μ m 孔径のテフロ ン製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を 得た。得られた組成物のプロピレングリコール含有量は 200ppm、ナトリウム含有量は1.2ppb、鉄含 有量は1.8ppbであった。得られた組成物をスピン コート法でシリコンウエハ上に塗布した。得られた塗膜 の**塗膜の膜厚は475nmであり、3σは8.4nmと** 良好であった。溶液の保存安定性を評価したところ、3 5日後の増膜率は4.3%と優れた保存安定性を示し た。また、塗膜の誘電率を評価したところ、2.69と

したところ、1. 2×10¹ Aと低いリーク電流が得 られた。

【0040】実施例2

合成例2で得られた反応液 ②を使用した以外は、実施例 1と同様にして評価を行った。得られた組成物のプロピ レングリコール含有量は205ppm、ナトリウム含有 量は1.8ppb、鉄含有量は2.2ppbであった。 得られた塗膜の塗膜の膜厚は433nmであり、3σは 9.9 nmと良好であった。溶液の保存安定性を評価し 10 たところ、35日後の増膜率は8.1%と優れた保存安 定性を示した。また、塗膜の誘電率を評価したところ、 2. 70と低い誘電率を示した。さらに、塗膜のリーク 電流を評価したところ、1.8×10⁻¹⁰ Aと低いリー ク電流が得られた。

【0041】 実施例3

合成例1で得られた反応液

①100gにアセチルアセト ン1gを添加した溶液を使用した以外は実施例1と同様 にして評価を行った。得られた組成物のプロピレングリ コール含有量は198ppm、ナトリウム含有量は1. 20 1 p p b、鉄含有量は1.7 p p b であった。得られた mと良好であった。溶液の保存安定性を評価したとこ ろ、35日後の増膜率は3.9%と優れた保存安定性を 示した。また、塗膜の誘電率を評価したところ、2.7 0と低い誘電率を示した。さらに、塗膜のリーク電流を 評価したところ、1. 5×10¹ Aと低いリーク電流 が得られた。

【0042】実施例4

合成例2で得られた反応液②100gに重量分子量約 30 4,000のポリメタクリル酸イソプロピル10gを添 加した溶液を使用した以外は実施例1と同様にして評価 を行った。得られた組成物のプロピレングリコール含有 量は205ppm、ナトリウム含有量は2.5ppb、 鉄含有量は3.3ppbであった。得られた塗膜の塗膜 の膜厚は399nmであり、3σは10.3nmと良好 であった。溶液の保存安定性を評価したところ、35日 後の増膜率は8.9%と優れた保存安定性を示した。ま た、塗膜の誘電率を評価したところ、2.32と低い誘 電率を示した。さらに、塗膜のリーク電流を評価したと 40 ころ、0.8×10^{1°}Aと低いリーク電流が得られ た。

【0043】実施例5

合成例2で得られた反応液②100gに重量分子量約 2,000のポリエチレングリコール10gを添加した 溶液を使用した以外は実施例1と同様にして評価を行っ た。得られた組成物のプロピレングリコール含有量は2 05ppm、ナトリウム含有量は3.4ppb、鉄含有 量は5.2ppbであった。得られた塗膜の塗膜の膜厚 は393nmであり、3σは10.2nmと良好であっ 低い誘電率を示した。さらに、塗膜のリーク電流を評価 50 た。溶液の保存安定性を評価したところ、35日後の増 膜率は9.1%と優れた保存安定性を示した。また、塗 膜の誘電率を評価したところ、2.22と低い誘電率を 示した。さらに、塗膜のリーク電流を評価したところ、 0. 6×10¹ Aと低いリーク電流が得られた。

21

【0044】比較例1

比較合成例1で得られた反応液③を使用した以外は、実 施例1と同様にして評価を行った。得られた組成物のプ ロピレングリコール含有量は15000ppm、ナトリ ウム含有量は53ppb、鉄含有量は88ppbであっ た。得られた鈴膜の塗膜の膜厚は476 n m であり、3 10 組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能であ σは40.2 n m と 塗膜均一性に劣るものであった。 溶

液の保存安定性を評価したところ、35日後の増膜率は 13.4%と保存安定性に劣るものであった。また、塗 膜の誘電率を評価したところ、3.02と高い誘電率を 示した。さらに、塗膜のリーク電流を評価したところ、 19. 5×10⁻¹⁰ Aと高いリーク電流が得られた。

【発明の効果】本発明によれば、アルコキシシランの加 水分解物および/またはその縮合物を特定の純度の溶媒 に溶解させることにより、塗膜均一性、保存安定性、誘 電率、リーク電流特性などのバランスに優れた膜形成用 る。

フロントページの続き

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

Fターム(参考) 4J002 CP031 EA016 EE026 EE048 EH026 EP016 EV206 EZ007 GQ01

> 5F058 AA03 AA10 AC03 AF04 AG01 AH01 AH02 BA06 BA20 BC05 BF46 BH01 BJ01 BJ02